

# 深圳精智达技术股份有限公司

## 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，结合公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

### 一、公司主营业务

公司专注于半导体测试检测设备及系统解决方案领域，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。

依托多年在半导体存储测试领域的深耕积累和自主创新，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、高速 FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。

公司 AMOLED 领域检测设备已覆盖京东方、TCL 科技、维信诺股份、深天马等主流厂商，市占率持续提升；在中尺寸 AMOLED 领域，为适配 IT/车载等新需求，公司积极研发可适用于 G8.6 AMOLED 产线的检测设备并取得批量订单；在微型显示领域，公司实现 Micro LED/Micro OLED 的信号发生器、晶圆检测设备、光学检测及校正修复设备、最终成品检测设备等产品的量产销售，并向海外头部 AR/VR 客户提供系统化检测解决方案。

公司已与国内主流半导体及新型显示制造厂商建立了紧密稳定的业务合作关系，相关产品的技术水平与上述客户的产品技术发展规划同步布局，竞争实力

逐步攀升，市场占有率不断扩大，持续有力地推进关键检测及测试工艺相关设备的自主可控和国产替代进程。

## 二、项目方案概述及必要性、可行性分析

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 290,190.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	半导体存储测试设备研发及产业化智造项目	半导体存储测试设备产业化智造项目	44,096.00	44,000.00
		半导体存储测试设备技术研发项目	38,124.00	38,100.00
	小计		82,220.00	82,100.00
2	高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目		158,800.00	153,800.00
3	补充流动资金		54,290.00	54,290.00
合计			<b>295,310.00</b>	<b>290,190.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

### （一）半导体存储测试设备产业化智造项目

#### 1、项目基本情况

本项目拟在深圳市龙华区购置土地建设高标准生产厂房、办公场地等配套设施，引入先进的生产配套设备及软件，打造标准化、现代化、规模化的半导体存储测试设备产业化基地。本项目的实施将进一步缓解公司生产场地主要依赖租赁取得以及生产场地空间瓶颈，有效提升公司高端半导体存储测试设备产业化能

力，充分满足下游市场及客户的产品需求，进一步提高公司核心竞争力和市场地位。

## 2、项目实施必要性

(1) 把握半导体存储行业发展机遇，满足下游客户对高端半导体测试设备产品的需求

DRAM 是现代信息技术和数字信息产业发展的重要基石，广泛应用于数据中心、移动设备及终端、通信、智能制造等领域。近年来，新兴技术场景持续涌现，数据总量呈现爆发式增长，广泛的数据读写与传输需求驱动全球 DRAM 市场规模快速扩大。根据 Omdia 数据，全球 DRAM 市场规模有望从 2024 年的 976 亿美元增长至 2029 年的 2,045 亿美元，年均复合增长率为 15.93%。全球 DRAM 市场需求直接拉动半导体存储测试设备需求快速增长。

同时，人工智能、高带宽存储芯片等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，显著提升了存储芯片的集成度与结构复杂度。异构集成与垂直堆叠技术在实现性能跨越的同时，也对测试效率、良率控制提出了更严苛要求。在此背景下，下游客户对高端半导体存储测试设备的需求呈现出快速增长趋势。

公司作为国内半导体存储器测试设备行业的领先企业，已初步建成系统化全站点服务能力，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、高速 FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，并且部分产线已成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，是促进国内集成电路产业链安全稳定发展的核心力量。

本次募投项目的实施将进一步提高公司在高端半导体存储测试设备领域的产业化能力，进而更好满足我国半导体产业迭代升级对测试设备的更高要求。

(2) 拓展高端半导体存储测试设备市场布局，加速推进高端半导体存储测试设备国产化进程，支撑公司持续高质量快速发展

受益于半导体产业前沿技术的快速发展，我国半导体存储测试设备产业正处

于技术水平提升的高速发展期，高端半导体存储测试设备市场将迎来广阔的市场空间。然而，目前半导体测试设备领域，尤其是高端产品市场，呈现国外龙头厂商寡头垄断的竞争格局。以半导体测试设备领域核心设备测试机为例，根据中国产业信息网及 SEMI 等公开资料数据，2024 年国外前两大测试设备厂商合计占据中国大陆测试机市场 80% 的市场份额，处于绝对的领先地位，国产化率水平相对较低，亟需进一步提升。

近年来，公司半导体测试设备业务规模及市场地位持续提升，但在经营规模和技术能力方面与国外厂商相比仍存在一定差距，本次募投项目的实施将进一步提高高端半导体测试设备产业化能力，加快公司在高端半导体测试设备市场布局，加速高端半导体测试设备国产化进程，支撑公司高质量快速发展。

(3) 依托深圳及大湾区成熟产业生态配套，加快高端半导体测试设备产业化进程

本次募投项目建设地点位于深圳市龙华区。深圳及大湾区的集成电路产业已形成全产业链生态，产业规模持续壮大。根据深圳市发改委数据显示，2025 年深圳半导体与集成电路产业规模首次突破 3,000 亿元大关，构建起自主可控、协同高效的产业生态体系，设备与材料领域国产替代成果显著，带动设备行业规模增至 356 亿元。

本次募投项目的实施将充分借助深圳及大湾区成熟产业生态配套，充分发挥高效协同供应链效应，以公司存储测试设备及相关产品为基础，不断丰富公司半导体测试设备产品类型和下游应用领域，加快产业化进程。

### 3、项目实施可行性

(1) 广阔的下游市场空间及优质客户基础为项目实施提供稳定市场保障

半导体产业作为信息技术产业的核心基石，拥有庞大的产业规模和持续的增长潜力。近年来，随着下游人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，我国半导体产业快速发展、晶圆产能持续扩张，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。半导体测试设备作为半导体生产制造过程的核心设备之一，市场规模增速显著。根据 SEMI 统计及预测，2025 年半导体测试设备销售额预计达到 112

亿美元，同比增长 48.1%，2026 年至 2027 年市场规模预计达到 125 亿美元和 134 亿美元，保持持续增长态势。半导体存储测试设备作为半导体测试设备中第二大细分市场，亦迎来高速发展期。

公司深耕于半导体测试检测设备领域，坚持以市场需求为导向，与国内头部半导体存储厂商建立了紧密稳定的业务合作关系。公司核心产品已应用于国内头部半导体厂商及其供应链，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。依托于前期积累的优质的客户资源优势和市场口碑，公司将持续进行新客户拓展，保障本次募投项目新建产量的有效消化。

## （2）深厚的产业化经验积累和技术沉淀为项目实施提供有力产业化保障

作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，公司始终以实现关键设备与核心技术的自主可控为战略基石，不断加大研发投入，在半导体存储测试领域已经形成了坚实的产品和技术储备。公司的系统化全站点布局能够有效支撑下游客户关键生产环节的自主可控需求。在探针卡、老化测试及修复设备方面，公司产品已实现规模量产，出货量稳步提升；在先进封装测试领域，公司已向国内重点客户交付首台高速测试机，持续深化对前沿场景的产品覆盖。在关键技术层面，公司在高速芯片测试领域取得重要突破，测试机专用 9Gbps ASIC 芯片已通过客户验证。公司深厚的产业化经验积累和技术沉淀为本次募投项目的产业化实施提供有力保障。

## （二）半导体存储测试设备技术研发项目

### 1、项目基本情况

本项目拟在深圳市龙华区建设研发场地，引入半导体存储测试设备技术和产品研发所需的先进的设备及软件，扩充研发团队，进一步提升公司研发实力。本项目的实施将持续推动公司半导体存储测试设备升级迭代，不断提高产品技术水平和核心竞争力。

### 2、项目实施必要性

(1) 紧跟行业发展趋势，依托深圳及大湾区产业集群优势，助推公司半导体存储测试设备产品升级迭代

半导体存储测试设备作为算力基础设施的关键支撑环节，面临持续增长的市场需求。同时，随着集成电路制造工艺向先进制程节点演进，以及 2.5D/3D、Chiplet 等先进封装技术的不断突破，芯片结构从平面走向立体，其复杂的互连结构与集成形态对测试设备的信号精度、多通道协同能力及系统兼容性等方面提出更高要求，驱动存储测试设备向高性能、高集成方向持续升级。

集成电路产业作为深圳及大湾区重点布局的产业集群，产业链结构日趋完善，从过去设计业“单点领跑”发展为制造、封测、设备、材料“多点支撑”的协同格局。据统计，深圳市半导体非设计业（制造、封测、设备、材料等）占比从 2020 年的 27% 攀升至 2025 年的 42%，形成了较为完备的集成电路产业链生态。

本次募投项目的实施旨在紧跟行业技术演进趋势，在深圳地区搭建起先进的软硬件研发环境，充分利用区域产业集群优势，重点推进公司半导体存储测试设备的性能提升与技术迭代，充分满足下游客户对高端测试设备日益增长的技术需求，巩固并提升公司在半导体存储测试设备领域的市场竞争力。

(2) 持续夯实技术创新能力，缩小与国际龙头厂商差距

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，国外龙头厂商凭借先发优势和持续高强度的研发投入已经形成一定的技术优势。公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力，在产品和技术方面具备较强的竞争优势，但与国外龙头厂商相比，在整体实力上仍存在一定差距。

本次募投项目将立足于公司现有的核心技术体系，践行“量产一代、在研一代、预研一代”的可持续研发节奏，持续加强研发投入，夯实并持续推动核心技术发展，以满足下游客户在半导体测试领域的多样化、复杂化需求，进一步推动我国高端半导体存储测试设备的国产化进程。

### 3、项目实施可行性

(1) 存储测试领域丰富的技术储备与产品布局，为项目高效实施与产业化落地提供保障

在技术储备方面，公司持续致力于研发创新，以构建半导体领域的系统化测试检测设备平台为核心目标。目前，公司已积累了全栈关键技术模块，包括电子系统设计、软件算法、精密机械自动化等。各技术模块相互支撑，共同构建了适配半导体测试、晶圆检测等场景的完整技术平台，能够满足半导体测试领域的多样化需求，核心技术整体水平在国内处于领先地位，为公司在存储测试领域的研发创新提供了坚实技术支撑。

在产品布局方面，公司以 DRAM 测试设备产品线为基础纵向延伸分选机、探针台等设备构建完整测试链，同步强化 HBM 及先进封装技术研究；依托 DRAM 技术储备横向拓展至 NAND FLASH 等存储测试领域，实现产品与技术的立体化布局，为本次募投项目的实施提供方向指引。同时，依托公司在半导体存储测试设备领域成熟的产业化能力，助力研发成果的高效转化与精准落地，实现技术研发与市场需求的无缝衔接。

依托于公司前期丰富的技术积累与立体化的产品布局，公司将进一步专攻半导体存储测试关键技术，紧跟行业发展和需求变化趋势，大力推动国内半导体存储测试设备领域的自主可控，在高端半导体测试设备领域打破海外长期垄断局面。

(2) 良好的外部环境 with 长期本地化经营积累，为项目实施奠定了坚实基础

深圳作为大湾区打造集成电路产业“第三极”的核心承载地之一，在集成电路产业生态构建上，已出台诸多鼓励政策，为企业技术攻关、资金扶持、人才保障方面提供全方位支持，为半导体设备企业的创新发展提供优质的政策和产业环境。

公司成立并深耕于深圳发展，深度融入深圳半导体产业发展，积累了丰厚的本地化产业资源、专业人才储备与良好的行业口碑。公司作为国内领先的半导体测试检测设备厂商，在产业资源方面，以业务、技术协同带动产业链上下游共同发展，树立了优质的品牌形象；在人才储备方面，公司构建“引进与培养并重”

的人才建设体系，打造了多领域、体系化人才梯队，核心技术团队行业经验丰富、结构稳定。与此同时，公司长期积淀的良好的社会声誉与后续经营发展中获得产业政策支持、吸引优秀人才、推动技术发展等方面形成正向循环，为本次募投项目的实施奠定了坚实基础。

### **（三）高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目**

#### **1、项目基本情况**

本项目拟在长三角打造高端芯片测试设备及前沿技术研发中心，购置先进的软硬件设施，引入优秀技术人才，助力公司深入开展研发活动，持续提升技术研发实力。本项目的实施将充分利用上海及长三角半导体产业区位和资源优势，重点开展公司半导体测试检测设备面向前沿需求的新产品及关键核心技术的研发工作，持续增强公司核心竞争力。

#### **2、项目实施必要性**

（1）前瞻性研发布局，聚焦高增长潜力的重点市场，巩固技术和产品领先性，持续夯实公司核心竞争壁垒，筑牢长期发展的护城河

近年来，以 AI 为代表的新一代前沿技术呈现加速渗透与规模化应用趋势，深刻重构全球半导体产业的竞争格局与技术演进路径。一方面，测试内容趋于复杂化，需要应对更庞大的数据流与更复杂的算法验证；另一方面，测试速度向高速化演进，以满足 HBM、算力芯片及先进封装等新兴技术的性能验证需求。AI 技术对高性能算力、高密度存力的极致诉求，叠加其对智能驾驶、云计算、边缘计算等新兴场景的应用落地，持续驱动半导体产业链上下游加速技术迭代、产品升级与制程革新，以算力芯片、HBM 为代表的高端芯片测试需求显著提升。受此影响，高端算力芯片测试设备和 HBM 测试设备等高端半导体测试设备将具有广阔的市场需求。与此同时，新一代前沿技术也为半导体测试检测设备厂商的技术升级提出更高要求。为此，需要持续的研发投入以确保产品和技术的先进性。

此外，在人工智能与人机交互浪潮的推动下，XR 等新兴设备的崛起为微显示技术带来了产业化提速与场景多元化的双重机遇。微显示技术向高分辨率、高对比度、广视场角的持续演进，倒逼检测设备进行技术升级，要求相关企业将

AI 算法与数据分析融入检测方案，通过提供定制化的解决方案，实现技术引领与产品革新。

本次募投项目的实施旨在进行前瞻性研发布局，通过对高端半导体测试设备、微显示测试领域检测技术以及 AI 相关技术在测试检测领域落地应用等持续研发投入与布局，持续打造公司技术和产品领先性，全面深化公司技术创新水平，助力我国半导体测试检测设备行业高质量发展。

(2) 自研高端测试系统的核心主控芯片，实现关键核心技术突破，确保高端半导体测试系统中 ASIC 芯片自主可控和供应链安全

半导体测试设备核心主控芯片是决定测试精度、测试效率和测试功能覆盖的关键核心部件。核心主控芯片的自主可控是构建高性能半导体测试设备核心竞争力的基石。核心主控芯片的自主可控不仅是突破高端技术壁垒、保障供应链安全的必要条件，更是降低测试成本、提升测试效率与市场竞争力的关键路径。

半导体测试设备主控芯片一般包括 ASIC 芯片和 FPGA 芯片两种类型，FPGA 芯片具有易开发特点，但性能上限相对较低，无法满足当前高端存储、算力芯片测试要求。ASIC 芯片具有高集成度、高测试速度、高测试精度、高可靠性和稳定性等特点，但芯片开发周期相对较长，具有较高的技术壁垒。国外龙头厂商的高端半导体测试设备主控芯片均采用专用 ASIC 芯片架构，以保证测试设备性能水平和稳定性。

公司以实现高端半导体测试设备及关键核心部件自主可控为目标，通过自研高端半导体测试系统的核心主控芯片，实现关键核心技术突破，是公司重要的长期战略举措。与此同时，国内主流半导体厂商积极构建本土产业链，必将成为半导体行业的关键驱动力，进一步推动高端半导体测试设备在核心环节的自主化攻坚。

本次募投项目的实施将助力公司进一步加大在高端测试机专用 ASIC 芯片领域的研发力度，进一步提高公司高端半导体测试设备关键核心部件的技术能力和产品附加值，缩小与国外龙头厂商的技术差距，增强核心竞争力。

(3) 依托于上海及长三角区位优势，提升公司技术及产品的创新能力和国际竞争力

上海凭借其完整的产业链生态、密集的高端人才、前沿的技术策源能力以及强大的政策资本支持，为半导体企业提供了最理想的成长土壤。截至目前，上海已建成全产业链齐头并进、相互支撑的集成电路产业链体系，在芯片设计、制造、封测、设备/材料、EDA/IP 等环节培育了一批行业细分领域龙头企业。2024 年上海集成电路产业规模突破 3,900 亿元，占全国比重超 25%，同比增幅达到 20%，预计 2025 年将突破 4,600 亿元，实现 24% 的高速增长。依托于强大的产业集聚效应，上海吸引了全国约 40% 的集成电路产业人才，从业人员超 20 万，为产业持续创新提供了智力引擎和多层次的人力资源保障。

集成电路与人工智能作为上海三大先导产业的重要组成，是我国半导体产业创新发展的核心承载区和战略高地。上海作为中国集成电路产业的核心引擎，在全球半导体产业链中占据举足轻重的地位。根据世界集成电路协会（WICA）发布的《2025 年全球集成电路产业综合竞争力百强城市白皮书》显示，上海在产业基础、创新能力、发展潜力和营商环境等方面表现突出，位列全球第四、国内第一。上海在全球及中国半导体产业中具有举足轻重的地位和影响力，是半导体企业进行战略布局的重点和核心。

本次募投项目的实施将充分依托上海及长三角地区半导体产业区位优势，借力产业链协同效应、高端人才集聚优势、下游市场需求旺盛等特点，吸引优质技术人才，进一步推动公司产品技术的创新发展，夯实公司核心技术护城河。

### 3、项目实施可行性

(1) 国家相关产业政策的大力支持为项目实施提供了良好的政策基础

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业发展的核心驱动力，近年来国家出台一系列鼓励扶持政策，为其高质量发展提供坚实支撑。

近年来，中共中央、国家发改委、工信部等部门陆续出台《中共中央关于制

定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021年修订）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》等产业政策，均提出强化半导体产业链发展，尤其是提高半导体测试检测设备自主供给能力。国家产业政策的大力支持为本次募投项目的实施打下坚实的政策基础。

### （2）丰富的人才和技术储备为项目实施提供了坚实的技术支撑

公司持续致力于研发创新，以构建半导体领域的系统化测试检测设备平台为核心目标。目前，公司已积累了全栈关键技术模块，各技术模块相互支撑，共同构建了半导体测试检测设备领域的完整技术平台。

公司通过构建“引进与培养并重”的人才建设体系强化核心竞争力：一方面持续引进高端技术人才，精准填补关键岗位空缺；另一方面深化校企合作从源头储备新生力量；同时建立完善的考核培养机制，系统性提升员工专业能力与市场竞争力。截至2025年6月末，公司研发人员数量为309人，构筑起了多领域、体系化的人才梯队。凭借较强的技术实力和丰富的技术积累，截至2025年6月末，公司累计取得知识产权466项，其中发明专利131项。公司丰富的人才和技术储备为本次募投项目的实施提供强大的技术支撑。

### （3）科学完善的研发体系为项目实施提供重要制度保障

完善、科学的研发体系架构及研发制度是保证研发活动正常开展，激发研发人员创造力的基础。作为创新驱动的半导体设备企业，公司始终以前瞻性技术开拓与战略规划为基点，通过自主研发、自主创新的研究模式持续拓展技术纵深与市场边界。公司重视研发体系的搭建以及相关制度的落实。目前，公司已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。

与此同时，公司制定了较为完善的研发工作流程制度。在研发实践中，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行开发并实现交付，在项目完成后将技术成果模块化与固

定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司研发输出符合市场需求的高质量产品，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。公司科学完善的研发体系为本次募投项目的实施提供有力的制度保障。

#### **（四）补充流动资金**

##### **1、项目基本情况**

公司本次募集资金拟使用 54,290.00 万元用于补充流动资金，有助于解决公司经营发展过程中对流动资金的需求，保障公司可持续发展。

##### **2、项目实施必要性**

公司所处行业为资金密集型行业，技术研发、生产运营及相关服务都需要大量的持续资金投入。目前，公司正处于业务发展重要机遇期，在巩固既有业务优势的同时，持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展，核心业务板块保持稳健增长。公司经营规模的持续扩大，带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求不断增加，加之存货、应收账款等经营性项目的资金占用规模相应增长，为了更好地开拓市场及支撑公司持续增长的采购需求，公司需要补充并维持一定规模的营运资金以支撑业务快速扩张。

##### **3、项目实施可行性**

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研发投入认定标准（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金有利于改善公司的资金状况，促进公司业绩增长，提升公司的盈利能力。

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

### **三、本次募集资金投向属于科技创新领域**

#### **(一) 本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务**

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。公司系专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力，公司所处行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，公司主营业务属于科技创新领域。

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目及补充流动资金，有助于提高公司科技创新水平，提高公司在高端半导体测试检测设备领域的研发及产业化能力，并补充流动资金满足公司未来经营规模的持续增长和技术研发需求。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

#### **(二) 本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升**

公司所处的半导体测试检测设备行业具有研发投入大、技术更新迭代快等特点。公司作为国内半导体测试检测设备领域领先者，已初步形成系统化全站点服务能力，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，并于部分产线已成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。为了进一步提高公司产品技术水平，持续满足下游新兴领域对高端半导体测试检测设备的技术需求，打破国外龙头厂商在国内市场的垄断局面。

公司将通过本次募投项目战略布局前沿技术领域，提高研发实力和研发效率，重点提高高端半导体测试设备和微显示检测设备的产品技术能力，加快新技术成果转化和产品研发产业化，进一步提升公司技术先进性。

### **四、结论**

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均

属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年5月20日